	文件名称	生产制程工艺名词术语		
	文件编号	GSB/M 102.01-2015	版 本	B0
	生效日期	2015-08-17	受 控 章	<div>受 控</div>
	页 次	第 1 页 共 7 页		

文件制 / 修订记录


制/修订日期	版本	页数	修订页次	修订记录
2011-01-05	A0	12	无	新版发行，GS-D-W-075 《生产工艺名词术语》
2015-08-12	B0	7	1-7	大篇幅修改，取代文件 GS-D-W-075 《生产工艺名词术语》

文件审批记录

制订部门	制订/日期	审核/日期	批准/日期
PCBA 部	苏启麟 2015-08-12	谢黎明 2015-08-13	朱霞 2015-08-14

文件分发部门

<input checked="" type="checkbox"/> SMT 部	<u>1</u> 份	<input type="checkbox"/> 总裁办	<u> </u> 份	<input type="checkbox"/> 平安城市	<u> </u> 份	<input type="checkbox"/> IT 流程体系部	<u> </u> 份
<input checked="" type="checkbox"/> PCBA 部	<u>1</u> 份	<input type="checkbox"/> 物控部	<u> </u> 份	<input type="checkbox"/> 研发中心	<u> </u> 份	<input type="checkbox"/> 行政服务中心	<u> </u> 份
<input checked="" type="checkbox"/> 品管部	<u>1</u> 份	<input type="checkbox"/> 采购部	<u> </u> 份	<input type="checkbox"/> 通信事业部	<u> </u> 份	<input type="checkbox"/> 技术资质中心	<u> </u> 份
<input type="checkbox"/> 业务部	<u> </u> 份	<input type="checkbox"/> 财务部	<u> </u> 份	<input type="checkbox"/> 品牌部	<u> </u> 份	<input type="checkbox"/> 人力资源与干部管理部	<u> </u> 份

	文件名称	生产制程工艺名词术语		
	文件编号	GSB/M 102.01-2015	版 本	B0
	生效日期	2015-08-17	受 控 章	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">受 控</div>
	页 次	第 2 页 共 7 页		

1 目的

1.1 为规范生产各工序工艺术语，使员工了解各种不良现象的正确描述，及减少员工对生产过程中的相似问题描述加以混淆，给支援部门分析不良问题、并进行改善提供正确信息；

2 范围

2.1 制造中心所有生产工序工艺术语定义；

3 定义

无

4 职责

4.1 制造中心 SMT 部负责 SMT 工艺名词术语的定义与编写、使用；


4.2 制造中心 PCBA 部负责 PCBA 工序工艺名词术语的定义与编写、使用；

4.3 品管部负责制造中心质量术语定义编写、使用以及监督制造中心工艺术语的使用；

5 作业程序

5.1 质量术语名词解释



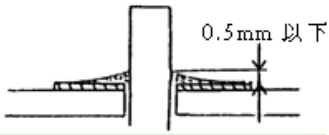
名词	解释	名词	解释
AQL	品质允收水准	ACC	允收
CLCA	闭环纠正措施	REJ	拒收
DPPM	百万分之不良率	BOM	材料清单
ECN	工程变更通知	FA	不良分析
FIFO	先进先出	IPQC	制程品质管制
NG	不良品	IQC	进料品质管制
ORT	可靠性测试	KPI	关键业绩指标
OQC	出货品质管制	N/A	不合适，不适用
OEM	原设备制造者	PCB	印刷电路板
ODM	原设计制造者	PCBA	组装电路板
QE	品质工程	P/N	料号
QCC	品管圈	P/O	采购单（订购单）
QC	品质管制	QA	品质保证
RMA	客退品职责	S/N	序列号
SIP	检验标准指导书	SOP	作业标准指导书
W/H	仓库	WIP	在制品


	文件名称	生产制程工艺名词术语		
	文件编号	GSB/M 102.01-2015	版 本	B0
	生效日期	2015-08-17	受 控 章	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">受 控</div>
	页 次	第 3 页 共 7 页		

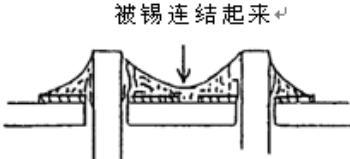


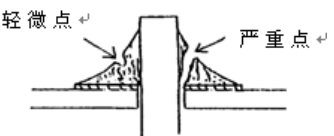

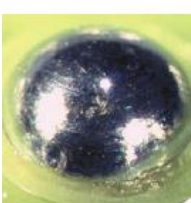

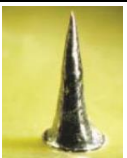
NPI	新产品导入	SCAR	供应商纠正措施报告
ESD	静电放电		


5.2 SMT 工艺名词术语解释参考《SMT 工艺名词术语》

5.3 制程不良名词术语解释：


现象	工序	定义	图片
错料	插件	物料使用错误规格	无
混料	插件	物料中存在两种以上的规格	无
漏件	插件	物料漏插	无
反向	插件	极性元器件极性方向错误与实际要求不符	无
跪脚	插件	物料零件脚未插入孔内（卡在器件与零件孔之间）	
翘脚	插件	物料零件脚未插入孔内（露在板上）	
浮高	插件	零件本体未紧贴 PCB 板，本体高度影响装配要求；	无
卡板	波峰焊	PCB 板卡在波峰焊内无法运行	无
掉板	波峰焊	PCB 板掉出波峰焊链条	无
溢锡	波峰焊	波峰焊锡炉波峰高度太高，锡溢到 PCB 板表面；	无
PCB 变形	波峰焊	PCB 板形状发生变化不在一个平面	无
少锡	后焊	焊锡不够饱满未形成正常焊点	

	文件名称	生产制程工艺名词术语		
	文件编号	GSB/M 102.01-2015	版 本	B0
	生效日期	2015-08-17	受 控 章	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">受 控</div>
	页 次	第 4 页 共 7 页		

连锡（锡短路）	后焊	不同电路焊点形成桥接	
虚焊（假焊）	后焊	焊点形状非正常，焊点边缘不顺畅	
空焊/不上锡	后焊	焊盘与零件脚未形成焊接；	
气孔	后焊	焊接温度与速度导致焊接表面出现针孔状	
锡球	后焊	甩锡或爆锡产生的球体，没有固定；	
包焊	后焊	无法识别器件脚的轮廓	
裂锡	后焊	破裂或有裂缝的焊接	
锡尖	后焊	焊接后 PCB 上局部钎料呈钟乳石状或冰柱形的现象，称为拉尖	





	文件名称	生产制程工艺名词术语		
	文件编号	GSB/M 102.01-2015	版 本	B0
	生效日期	2015-08-17	受 控 章	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">受 控</div>
	页 次	第 5 页 共 7 页		


锡渣	后焊	焊接因甩锡或锡爆产生的残锡附在 PCB 表面;	
铜箔翘皮	后焊	焊盘铜箔受外力影响导致铜箔翘起;	
PCB 起泡	后焊	PCB 板面出现区别于正常绿油颜色的区域并出现形变;	
撞料	后焊	因受外界应力导致零件破损	无
脏污	后焊	焊点周围因助焊剂/焊油等形成的固化物	
开路	后焊	焊盘线路断开导致无法不导通;	无
不通电	测试	设备电源无法启动	无
无显示	测试	设备显示界面无画面显示	无
不稳定	测试	测试过程出现时好时坏的现象	无
不运行	测试	电源可启动但测试程序不跑	无
误判	测试	测试因顶针解除、接口松动、测试方法等导致将（不）良品测试成（不）良品的现象	无
烧毁	测试	测试过程出现明显烧焦、爆炸等现象造成的现象	无
漏锁螺丝	装配	螺丝漏装	无
螺丝滑牙	装配	螺丝因扭力和螺丝批头匹配导致螺丝表面损坏	无
锁不到位	装配	螺丝锁附未紧贴结构部分	无


	文件名称	生产制程工艺名词术语		
	文件编号	GSB/M 102.01-2015	版 本	B0
	生效日期	2015-08-17	受 控 章	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">受 控</div>
	页 次	第 6 页 共 7 页		

异物	装配	装配过程密封结构有未固定的物体，影响产品功能	无
装偏	装配	结构部分未对正位	无
来料不良	装配	装配过程出现的不一致/与规格不符的现象	无

5.4 PCBA 工艺名词术语

名词	解释	图片
插件	将电子元器件类的物料装插到印制板上的过程	
板面/底目检	元器件装插完毕，波峰焊接之前，对所插元器件从正/反面进行检查是否存在插件错误等的过程；	
波峰焊接	即将熔融的液态钎料借助泵的作用，在钎料液面形成一特定形状的钎料波峰，装载了元器件的PCB以某一特定的角度，并以一定的浸入深度穿过钎料波峰而实现焊点的钎接过程称为波峰焊接	
剪脚	对印制板反面元器件的管脚进行修剪，使之符合元器件的管脚剪脚工艺要求的过程；	
补焊	（压面、执锡）对印制板反面焊点的焊点进行修补，使之符合元器件的焊点焊接工艺要求的过程；	

	文件名称	生产制程工艺名词术语		
	文件编号	GSB/M 102.01-2015	版 本	B0
	生效日期	2015-08-17	受 控 章	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">受 控</div>
	页 次	第 7 页 共 7 页		

功能测试	对印制板按照功能检测指导书进行通电检查的过程；	
装配	将各部件组合在一起构成整机设备的过程；	
点胶	对印制板上需要点胶的元器件，按照元器件点胶作业指导书进行点胶固定的过程；	
老化	高温通电运行验证设备的可靠性	
预成型	对元器件尺寸、形状按照工艺要求进行预加工	

- 6 相关文件
- 无
- 7 相关表单
- 无
- 8 流程图
- 无
